



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203543273 U

(45) 授权公告日 2014. 04. 16

(21) 申请号 201320235096. 0

(22) 申请日 2013. 05. 04

(73) 专利权人 南昌科创信息咨询有限公司  
地址 330000 江西省南昌市东湖区中山路  
185 号 D 栋 1106 室

(72) 发明人 尹湘平

(51) Int. Cl.  
B32B 33/00 (2006. 01)

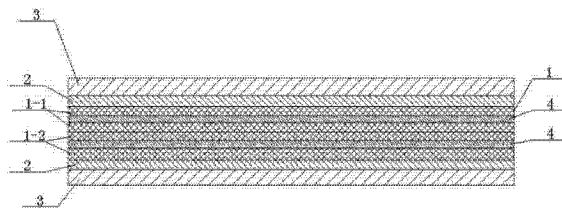
权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

环保型多层叠合式无铅制程覆铜板

(57) 摘要

环保型多层叠合式无铅制程覆铜板, 它涉及电子元器件技术领域, 它包含基本板 (1)、阻燃层 (2) 和铜箔层 (3); 基本板 (1) 的外侧设置有阻燃层 (2), 阻燃层 (2) 的外侧设置有铜箔层 (3)。它为无铅制程, 比较环保, 对环境危害较小, 且其内层设置有阻燃层, 实用性强。



1. 环保型多层叠合式无铅制程覆铜板,其特征在于它包含基本板(1)、阻燃层(2)和铜箔层(3);基本板(1)的外侧设置有阻燃层(2),阻燃层(2)的外侧设置有铜箔层(3)。
2. 根据权利要求1所述的环保型多层叠合式无铅制程覆铜板,其特征在于所述的基本板(1)包含第一基本板(1-1)和第二基本板(1-2),第一基本板(1-1)和第二基本板(1-2)的内部设置有屏蔽层(4)。

## 环保型多层叠合式无铅制程覆铜板

[0001] 技术领域：

[0002] 本实用新型涉及电子元器件技术领域，具体涉及一种环保型多层叠合式无铅制程覆铜板。

[0003] 背景技术：

[0004] 覆铜板——又名基材。将补强材料浸以树脂，一面或两面覆以铜箔，经热压而成的一种板状材料，称为覆铜箔层压板。它是做 PCB 的基本材料，常叫基材。

[0005] 目前的覆铜板大多数都是有铅的，不环保，对环境影响较大，而且目前的覆铜板没有阻燃层，实用性不强。

[0006] 实用新型内容：

[0007] 本实用新型的目的是提供一种供环保型多层叠合式无铅制程覆铜板，它为无铅制程，比较环保，对环境危害较小，且其内层设置有阻燃层，实用性强。

[0008] 为了解决背景技术所存在的问题，本实用新型是采用以下技术方案：它包含基本板 1、阻燃层 2 和铜箔层 3；基本板 1 的外侧设置有阻燃层 2，阻燃层 2 的外侧设置有铜箔层 3。

[0009] 所述的基本板 1 包含第一基本板 1-1 和第二基本板 1-2，第一基本板 1-1 和第二基本板 1-2 的内部设置有屏蔽层 4。

[0010] 本实用新型具有以下有益效果：它为无铅制程，比较环保，对环境危害较小，且其内层设置有阻燃层，实用性强。

[0011] 附图说明：

[0012] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0013] 具体实施方式：

[0014] 参看图 1，本具体实施方式采用以下技术方案：它包含基本板 1、阻燃层 2 和铜箔层 3；基本板 1 的外侧设置有阻燃层 2，阻燃层 2 的外侧设置有铜箔层 3。

[0015] 所述的基本板 1 包含第一基本板 1-1 和第二基本板 1-2，第一基本板 1-1 和第二基本板 1-2 的内部设置有屏蔽层 4。

[0016] 本具体实施方式为无铅制程，比较环保，对环境危害较小，且其内层设置有阻燃层，实用性强。

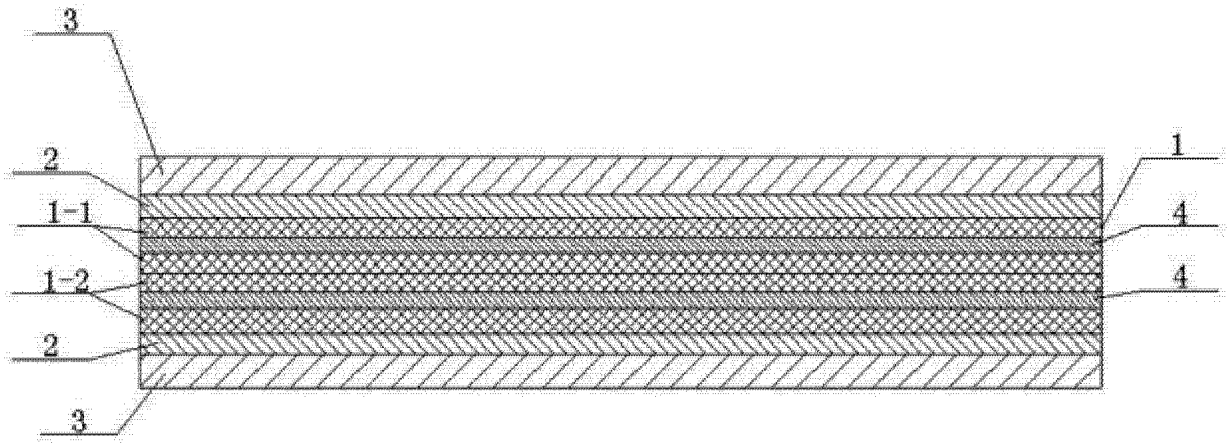


图 1